**西安高新科技职业学院**

**云桌面公共机房建设合同**

甲方：西安高新科技职业学院

乙方：西安巨宁电子科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买、卖双方就买卖交易事宜经过平等协商，确认根据下列条款订立本合同，以共同遵照执行。

**一、货物清单及价格：**见附件

**二、质量与技术标准和产品包装**：

质量与技术标准：以符合货物说明书的相关说明为准。

**三、交货的时间、方式、运输和保险：**

1、交货时间为：具体到货时间依据物流送货时间为准。

2、交货方式：对于货物清单，买方同意卖方可以按照一次性交货或分批交货形式履行合同交货义务。（如果是分批交货，注明每次交货的时间、交货内容）

3、运输方式以及运费承担：由卖方承担。

**四、付款方式**

协议总价款为人民币（大写）:壹佰叁拾壹万元整（￥1310000.00），其支付比例按照以下约定执行。合同（协议）生效后一个月内之内预付合同总价款50%的款项；供货到位，甲方验收合格后 一周内支付合同总价款30%的款项；系统调试正常运行6个月后支付合同总价款17%；质保期满一年后付合同总价款的3%的款项。

**五、验收与异议：**

1、买方如指定由收货单位（人）接收货物，则买方同意对收货单位（人）的接收、拒收、书面拒收意见等行为负责。

2、接收流程：

（1）采用送货上门方式交货的，在卖方交付货物时，买方应立即对货物品牌、规格、型号、数量是否符合合同规定进行检查验收，符合合同规定的，买方应当签收。对于不符合合同规定的货物，买方可以拒收，但应即时出具书面意见，说明拒收的理由，若无正当理由又拒绝签收的，买方应当承担货物送至双方约定收货地址后的一切风险。对于以送货上门方式交货，买方依照约定拒收的货物，买方应负责免费提供暂时性保管。

（2）采用代办托运方式交货的，自货物运到之日起5日内，买方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对货物的品牌、规格、型号、数量进行验收。验收不合格的，应即向卖方提出书面异议并对货物提供免费的暂时性的保管服务。在货物交付后5日内，买方未在约定期限内提出异议，视为货物通过验收。买方的异议被卖方接受且卖方同意给其调换或修理的，买方应负责按卖方同意的运输方式和费用将该货物运至卖方指定的接收人，由此产生的必要费用由卖方承担。

3、其他**：**

（1）买方因使用、保管、保养不善等造成货物质量下降的，不得提出异议。

（2）上述拒收或异议属于卖方责任的，由卖方在3日内负责更换或补齐。

**六、相关服务：（如货物的安装、技术服务支持、保修）**

买方负责供货、安装调试，所有货物均由原厂负责保修服务。

**七、争议解决方式：**

在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，任意一方均可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**八、合同效力及变更：**

1、本合同自双方加盖公章或合同章后生效；

2、合同生效后，买卖双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效.如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

3、如果卖方在签订后发现买方的关联公司对卖方或卖方的关联公司有超期欠款，卖方可终止履行本合同。

4、特别约定：

（1）买卖双方均承认其已审阅、理解本合同主文及相关附件的全部内容，并同意取代买卖双方之间此前关于本合同项下之合作所做出的任何口头或书面的承诺。

（2）本合同生效后，如果买方尚未结清应向卖方支付的款项的，卖方有权拒绝履行或解除本合同。

5、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金及其他各种经济损失，应当在明确责任后十日内支付给对方，否则按逾期付款处理。

6、本合同一式贰份，双方各执壹份，具同等法律效力。

甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：

法定代表或代理人 法定代表或代理人

年 月 日 年 月 日

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **配置组名称** | **产品型号** | **描述** | **数量** | **单价（万元）** | **总价（万元）** |
| **1** | **超融合服务器** | H3C UIS-Cell 3030 G3 | 4 \* H3C UIS-Cell 3030 G3 12LFF 超融合一体机; 8 \* H3C UniServer R4900 G3 6226R(2.9GHz/16核/22MB/150W)CPU模块(CMCTO); 32 \* 32GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM内存模块(CTO&BTO); 4 \* 12LFF 硬盘扩展模块(支持8LFF硬盘和4NVMe SSD)(FIO); 8 \* 600GB 12G SAS 10K 3.5in EP 512n HDD通用硬盘模块(FIO); 16 \* 12TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块(FIO); 8 \* 1.92TB PCIe\*Gen4 X4 NVMe U.2 3.5in RI PM9A3 SSD通用硬盘模块(CTO&BTO); 4 \* FHHL/NVMe转接卡模块(槽位1/2)(支持1个X8 FHHL,支持4个NVMe)(CMCTO); 4 \* FHHL转接卡(槽位1/2)(支持3个X8 FHHL)(FIO); 4 \* LSI G2 Flash掉电保护模块(含超级电容)(2U标卡RAID)(FIO); 4 \* LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口,1G缓存,不含掉电保护)(FIO); 8 \* 2端口万兆光接口网卡(SFP+)-520F-B2; 4 \* 4端口GE电接口MLOM(X722)网卡-360T L3(FIO); 8 \* 800W 交流&240V高压直流电源模块(LT-R1-白金)(CMCTO); 4 \* SAS HD转接电缆-0.89m-(SAS HD 72Pin直)-(SAS Cable)-(SAS HD 72Pin直); 4 \* OCulink转接电缆-0.77m-(4\*(OCulink 42pin直))-(SAS Cable)-(4\*(OCulink 42pin直)); 4 \* 2U标准风扇模块(FIO); 4 \* H3C UIS一体机预装模块(FIO); 4 \* 2U安全面板(FIO); 4 \* 2U标准滑轨-A; 4 \* H3C服务器首次基础安装服务 | 3 | 8.83 | 26.49 |
| **2** | **云桌面管理软件** | H3C Workspace | 4 \* H3C VDI 云桌面分布式存储软件(VDI-ONEStor)-块存储标准版License-管理2个物理CPU;  240 \* H3C Workspace 云桌面管理软件 1 License;  7 \* H3C云桌面管理系统规划部署服务;  H3C 软件技术支持服务(三年) | 1 | 59.40 | 59.40 |
| **3** | **云终端硬件** | H3C C113L+ | 240 \* H3C C113L+ ARM Cortex A17 4核/2GB DDR3L/8GB Flash/6\*USB/1000M/挂架云终端-Linux;  240 \* H3C D20WA+宽屏显示器 | 120 | 0.32 | 37.92 |
| **4** | **存储网交换机** | H3C S6520X-30QC-EI | H3C S6520X-30QC-EI L3以太网交换机主机(24SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),无电源;  8 \* SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC);  40G QSFP+ 3m电缆;  2 \* 250W 交流电源模块（电源面板侧出风）;  2 \* 端口侧进风,电源侧出风风扇 | 2 | 1.95 | 3.89 |
| **5** | **业务管理交换机** | H3C S5130S-28S-EI | H3C S5130S-28S-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC;  2 \* SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC);  SFP+电缆3m | 2 | 0.48 | 0.96 |
| **6** | **接入交换机** | H3C S5130S-52S-EI | H3C S5130S-52S-EI L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC;  2 \* SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 3 | 0.78 | 2.34 |
| **7** | **云桌面安全态势感知管控平台** | H3C MSR3600-28-X1（态势感知增强版） | H3C MSR3600-28-X1态势感知增强版主机(27GE(RJ45)+2GE(SFP),4 SIC槽位) | 1 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** |  |  |  |  | **131.00** |